

■電子デバイス

認定製品		トップレベルの環境技術(注1)		認定時期	製品情報	
FRAM	FRAM MB85RS64	省エネ	動作時・待機時消費電流を低減	2012年2月	製品サイト	富士通セミコンダクター(株)
		化学物質	REACH規制対象物質非含有 他			
	FRAM MB85R1001A,MB85R1002A	省エネ	待機時消費電流を低減	2012年1月	製品サイト	富士通セミコンダクター(株)
		化学物質	REACH規制対象物質非含有 他			
	FRAM MB85R4001A,MB85R4002A	省エネ	待機時消費電流を低減	2012年1月	製品サイト	富士通セミコンダクター(株)
		化学物質	REACH規制対象物質非含有 他			
	FRAM MB85RC16	省エネ	動作時消費電流を低減	2011年12月	製品サイト	富士通セミコンダクター(株)
		化学物質	REACH規制対象物質非含有 他			
ASSP	映像用IC MB86A51	省エネ	動作時消費電力を削減	2013年2月	製品サイト	富士通セミコンダクター(株)
		3R設計・技術	周辺部品点数を削減			
		化学物質	REACH規制対象物質非含有 他			
	トランスコーダLSI MB86H57/MB86H58	省エネ	消費電力40%削減。業界トップクラスの低消費電力。	2010年3月	—	富士通セミコンダクター(株)
		3R設計・技術	パッケージサイズをMB86H57で77%削減。MB86H58で26%削減。			
ベースバンドLSI MB86K22/MB86K23	省エネ	消費電力36%削減。	2010年3月	—	富士通セミコンダクター(株)	
コンソールドロワー	FD-5316AT	省エネ	動作時消費電力44%削減、待機時消費電力89%削減	2013年3月	—	富士通コンポーネント(株)
		化学物質	鉛フリーはんだ使用			
	FD-5308AT	省エネ	動作時消費電力23%削減、オフ時消費電力90%削減	2012年4月	—	富士通コンポーネント(株)
		化学物質	鉛フリーはんだ使用			
手のひら静脈認証	PalmSecure(tm)-EP	省エネ	待機時消費電力を73.3%削減。	2011年4月	製品サイト	富士通フロンテック(株)
		3R設計	製品質量を61.9%、体積を71.6%削減			
ポインティングデバイス	N01B-4824-B811/20	省エネ	待機時の消費電力を約50%削減	2010年2月	—	富士通コンポーネント(株)
電子デバイス	特定省電力無線モジュール MBH7SLZ01	省エネ	製品分野でトップレベル相当の消費電力	2015年3月	製品サイト	富士通コンポーネント(株)
		3R設計・技術	受信感度を高めたことで、他社製品と比較し少ない台数で通信が可能。			
		化学物質	プリント基板にハロゲンフリー材を使用。			
	無線LANモジュール MBH7WLZ23	省エネ	他社製品と比較して待機時消費電力を41%低減。	2010年9月	製品サイト	富士通コンポーネント(株)
		3R設計・技術	製品分野でトップレベルの小型化。			
		化学物質	プリント基板にハロゲンフリー材を使用。			
コネクタ	88形コネクタ ストレートジャック	3R設計・技術	体積を20.9%削減。	2010年2月	—	富士通コンポーネント(株)
	260S形コネクタ	3R設計・技術	部品点数を36%削減	2009年3月	—	富士通コンポーネント(株)
リレー	FTR-V2形リレー	省エネ	単位消費電力当たりの連続通電能力向上	2013年3月	—	富士通コンポーネント(株)
		化学物質	REACH規制対象物質非含有 他			
	FBR51ラッチ形リレー	省エネ	待機時消費電力82%削減、ライフサイクル全体でCO2 46%削減	2012年4月	製品サイト	富士通コンポーネント(株)
		3R設計	性能当り体積86%削減			
	FTR-K3L形リレー	省エネ	自己保持形リレーで待機時消費電力が0W。	2011年2月	—	富士通コンポーネント(株)
		化学物質	鉛フリーはんだを使用。REACH規制対象物質非含有。			
	FTR-K2W形リレー	省エネ	他社同等品と比較して待機時消費電力を40%削減	2009年8月	—	富士通コンポーネント(株)
		3R設計・技術	他社同等品と比較して体積70%削減			
FTR-F3P形リレー	3R設計・技術	体積を65%削減(TV-5クラスで最小)	2009年3月	—	富士通コンポーネント(株)	
FTR-F1L形リレー	省エネ	他社同等品と比較して待機時消費電力0W	2009年3月	—	富士通コンポーネント(株)	
タッチパネル	マルチインプットタッチパネル	3R設計・技術	他社同等品と比較して部品点数を17%削減。	2010年3月	—	富士通コンポーネント(株)
		化学物質	製造プロセスでのPFOS不使用。			
	クッション付タッチパネル	3R設計・技術	部品点数を37.5%削減、製品分解時間を30%削減	2009年3月	—	富士通コンポーネント(株)
		化学物質	製造プロセスでのPFOS不使用			
キーボード	FA用小型軽量T618	3R設計・技術	質量を20%削減	2009年3月	—	富士通コンポーネント(株)

注1：トップレベルの環境技術に記載されている事項は提供開始時点での従来製品との比較情報です。

本ページでご紹介している製品の中には現在販売されていないものも含まれています。